

フォトニクスや光学部品の製造、設計、研究の課題を解決するためのテスト

Smarter
network
in sight.

EXFO

EXFOについて

EXFOは、世界の通信業界向けに、よりスマートなテスト、モニタリング、分析ソリューションを開発しています。

フォトニクスのテストでは、どのように先行しているのか

私たちは、部品メーカーが大量生産環境においてエンドツーエンドのテストを可能にするターンキーソリューションを必要としていることを認識しています。EXFOは、自動化、スケーラブル、高速、高精度、コスト最適化を実現するハードウェアおよびソフトウェアソリューションにより、比較的新しい分野であるフォトニック集積回路(PIC)テストにおいて業界をリードしています。これらの革新的なソリューションは、サードパーティの装置(例: ウェハディスクハンドリングシステム)と相互運用することができます。

業界最速のPICテストシステムを設計し、「1ダイナミックレンジ」タイプの光検出器を使用することで、迅速かつ再現性の高い測定を実現しています。

この革新的なソリューションは、さまざまなコンポーネントを1つのチップに統合し、機能性と密度を高めると同時に、製造コストとエネルギー要件を低減させるものです。光結合方法の革新により、ウェハーレベルのテストが大量生産可能になり、テストの大幅な簡素化とスピードアップが実現しました。

EXFOの業界をリードする受動・能動光学部品テストソリューションは、特許取得済みのユニークな利点により、パー、ダイ、ウェハーディスクレベル、パッケージ部品など、フォームファクタに関係なくテスト効率を向上させます。自動化と光学的同期化により、高精度で信頼性の高い測定が可能です。

テストプロセスをエンドツーエンドでサポートする



ワンストップ・ショップ

最適な研究開発・製造を実現するための専門知識とソリューションを提供します。



より速いレスポンスタイム

コスト削減と市場投入までの時間短縮の為に包括的なテストを経由します。



シームレスな統合

既存プロセスとのシームレスな統合を実現します



お客様の投資を保護するために

現在も、そしてこれからも、最適な価値を提供する未来志向のソリューションによって投資を保護します。



カスタマイズされたソリューション



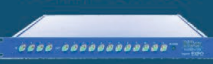










必要に応じて、業界とのコラボレーションによって生み出される



正確で再現性の高い結果を

大量生産に対応するための自動化と先進的なスペックにより、正確で再現性の高い結果を提供します。

革新的なPICテスター

<p>LAB-ON-A-RACK – PASSIVE + ACTIVE</p> <p>Optical test platform Light sources, VOA, opt. switch, OSA, power meters</p>  <p>LTB-12</p>  <p>OSICS</p> <p>Matrix switch</p>  <p>MXS-9100</p>	<p>SPECTRAL – PASSIVE COMPONENT</p> <p>Swept tunable lasers</p> <p>NEW</p>  <p>T200S</p>  <p>T500S</p> <p>Passive optical component testers</p>  <p>CTP10</p>  <p>CT440</p>	<p>SPECTRAL – ACTIVE COMPONENT</p> <p>Optical spectrum analyzer</p>  <p>OSA20</p> <p>Tunable filters</p>  <p>XTA-50</p>  <p>XTM-50</p>	<p>TRAFFIC ANALYSIS</p> <p>BER tester</p>  <p>BA-4000</p> <p>Sampling scope</p>  <p>EA-4000</p> <p>Clock recovery</p>  <p>CD-4000</p>
--	--	--	---

お客様のニーズに合わせたソリューション

他の先駆的な業界関係者と緊密に連携、カスタマイズされたソリューションを設計し、複数のPICメーカーに成功した実績があります。

- EXFOは、Hewlett Packard Enterprise (HPE) および MPI Corporation と提携し、研究開発ラボのテストから本格的な製造までのアプリケーションをサポートする為に、ウェアレベルでの合理化、低消費電力、自動化、完全統合のPICテストに取り組んでいます。ウェーハディスクはHPEが、ウェーハハンドリングとプローブアライメントはMPIが、光学テストと計測はEXFOが担当します。
- PICの発明者であり、マイクロオプティカルスイッチのリーダーであるAEPONYXは、高度なシリコンフォトニックデバイスの処理を高速化するソリューションを必要としていました。EXFOは、AEPONYX社および総合エレクトロフォトニクスプローブシステム開発会社であるMaple Leaf Photonics社 (MLP) と共同で、完全自動の光電気プローブシステムの設計とカスタマイズを担当しました。このシステムは、デバイス特性評価のための大規模なデータセットを生成できる超高速光学試験装置を使用しています。この統合されたソリューションにより、ウェアテストの速度は、以前の技術に比べて10倍以上向上しました。
- Tower Semiconductor社は、EXFO社のCTP10受動光学部品テストユニットとMPI Corporation社のTS3000ウェーハディスクハンドラを組み合わせたシステムを使って、PICテストを最適化しました。この組み合わせは、PICデバイスごとに異なるテストセットアップをサポートする拡張性とカスタマイズ性という同社のファウンドリに基づく2つの要件と、PICエコシステム全体でトレーサブルな正確なテスト測定という顧客のニーズを満たしています。

We are here to help.

Contact your [EXFO sales representative](#) to learn more about our testing solutions for photonics or visit [EXFO.com](#)

EXFO